

证券代码：688757

证券简称：胜科纳米

编号：2026-003

## 胜科纳米（苏州）股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位	线上参与公司 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的全体投资者
时间	2026 年 6 月 4 日
地点	上海证券报·中国证券网路演中心 ( <a href="https://roadshow.cnstock.com/">https://roadshow.cnstock.com/</a> )
上市公司接待人员姓名	1. 董事长兼总经理：李晓旻 2. 董事会秘书：周秋月 3. 财务负责人：洪凯 4. 独立董事：张毅
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、胜科纳米的定增项目目前处于什么阶段？</b> 答：尊敬的投资者您好，感谢您对胜科纳米的关注！公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案已经董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会、股东会审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日披露的相关公告。公司将严格遵照监管规定，稳步推进相关工作，定增项目实际申报时间及进展情况敬请关注公司后续披露的有关公告。</p> <p><b>2、公司 2025 年及 2026 年一季度营业收入增长的主要原因是什么？</b> 答：尊敬的投资者您好，感谢您对胜科纳米的关注！2025 年公司实现营业收入 5.30 亿元，同比增长 27.51%；2026 年第一季度公司实现营业收入 1.32 亿元，同比增长 21.96%。公司营收规模实现较快增长主要原因是在人工智能、自动驾驶等下游应用的强劲驱动下，高性能计算芯片、高带宽存储芯片及先进封装等技术需求旺盛，驱动第三方检测分析需求增长，公司核心客户订单规模显著增加；同时公司积极拓展新客户资源，也为业务增长提供了新的动力。</p>

### **3、五代线已有客户验收或量产级订单了吗？**

答：尊敬的投资者您好，感谢您对胜科纳米的关注！公司第五代产线重点聚焦高性能计算芯片、存储芯片、先进封装等领域的系统级多芯片集成分析，目前处于中试阶段，整体运营状态良好，订单月环比持续上升。公司将通过技术能力提升、客户关系维护和新业务拓展等多方面举措，进一步巩固和扩大第5代产线的市场份额。

### **4、利润何时回正增长？有时间表吗？**

答：尊敬的投资者您好，感谢您对胜科纳米的关注！半导体第三方检测分析企业通常需要前瞻性布局与设备、人员储备，前期投入较大，在5G、AI等新兴应用推动半导体技术持续迭代影响下，同时随着公司及子公司实验室产能逐步释放，公司收入结构不断优化，利润有望得到提升。

### **5、公司目前来自半导体哪些领域的客户收入占比较多以及未来的展望？**

答：尊敬的投资者您好，感谢您对胜科纳米的关注！公司主要是服务于半导体企业的研发环节，2025年主营业务收入中，来自芯片设计、晶圆代工、设备及材料环节客户的收入占比较高，合计占比达到80%左右。随着AI产业热潮的推动、半导体国产化进程的深化，芯片设计、晶圆制造、半导体设备、先进封装等企业对产品性能和生产良率的提升有更高要求，进而加速了产品研发与工艺升级的进程，研发阶段的新产品设计与新工艺研究、新产品检测与新产线调试等环节，催生出大量的检测分析需求，第三方检测分析服务市场前景广阔。

### **6、目前来自GPU客户的收入占比有多少？**

答：尊敬的投资者您好，感谢您对胜科纳米的关注！公司具备为GPU等高性能算力芯片提供失效分析、材料分析、可靠性分析服务的能力，已形成电性测试及光热点探测失效定位技术、高分辨率透射电镜成像结构检测分析技术等核心技术，可满足GPU客户在先进制程、先进封装等不同工艺分析要求。2025年公司来自GPU客户的订单呈上升趋势，受商业保密及信息披露相关法规约束，具体客户信息及收入情况请关注公司定期报告等公开披露信息。

### **7、半导体公司的制程从14nm演进到7nm、5nm，以及近期华为韬定律的提出，是如何影响公司业务的？**

答：尊敬的投资者您好，感谢您对胜科纳米的关注！随着半导体制程向更先进节点持续演进，工艺尺寸已逐步逼近物理极限，显著提升了芯片集成度和复杂性，直接推动了对高精度检测分析服务的需求增长。同时近期韬定律的提出，强调

	<p>“时间缩微”技术路线，通过逻辑折叠等设计创新，这将催生多维度新的检测分析需求。如当前数据中心和 AI 计算领域的高端芯片多属于高度集成的系统级集成芯片，并通过 2.5D/3D 等先进封装技术实现多芯片异构集成，相关制造工艺的低容错率与产品复杂度持续攀升，显著增加了对检测分析服务的需求，对公司业务增长具有显著的积极影响。</p> <p><b>8、关注到公司近期完成了工商变更，修改了公司经营范围，增加“人工智能基础软件开发、人工智能通用应用系统”等经营内容，公司未来是有什么新的经营举措吗？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好，感谢您对胜科纳米的关注！近年来，公司持续探索 AI 技术在半导体检测分析领域的创新应用，将智能算法融入材料分析、失效分析和可靠性分析等核心业务流程，有效提升检测效率与分析精度。未来公司将搭建半导体检测分析垂类大模型与智能体应用体系，助力公司实现业务模式升级，构筑差异化竞争壁垒。目前公司已完成经营范围变更，后续在确保半导体检测分析主营业务稳健发展的前提下，将相关 AI 研发成果稳步推进商业化落地。</p>
<p><b>风险提示及说明</b></p>	<p>以上如涉及对行业的预测、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的盈利预测和承诺，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>业绩说明会过程中，公司积极回复投资者提出的问题，回复的内容符合公司《信息披露管理制度》等制度的规定，回复的信息真实、准确，本次活动不存在应当披露的重大信息。</p>
<p><b>附件清单（如有）</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2026 年 6 月 4 日</p>